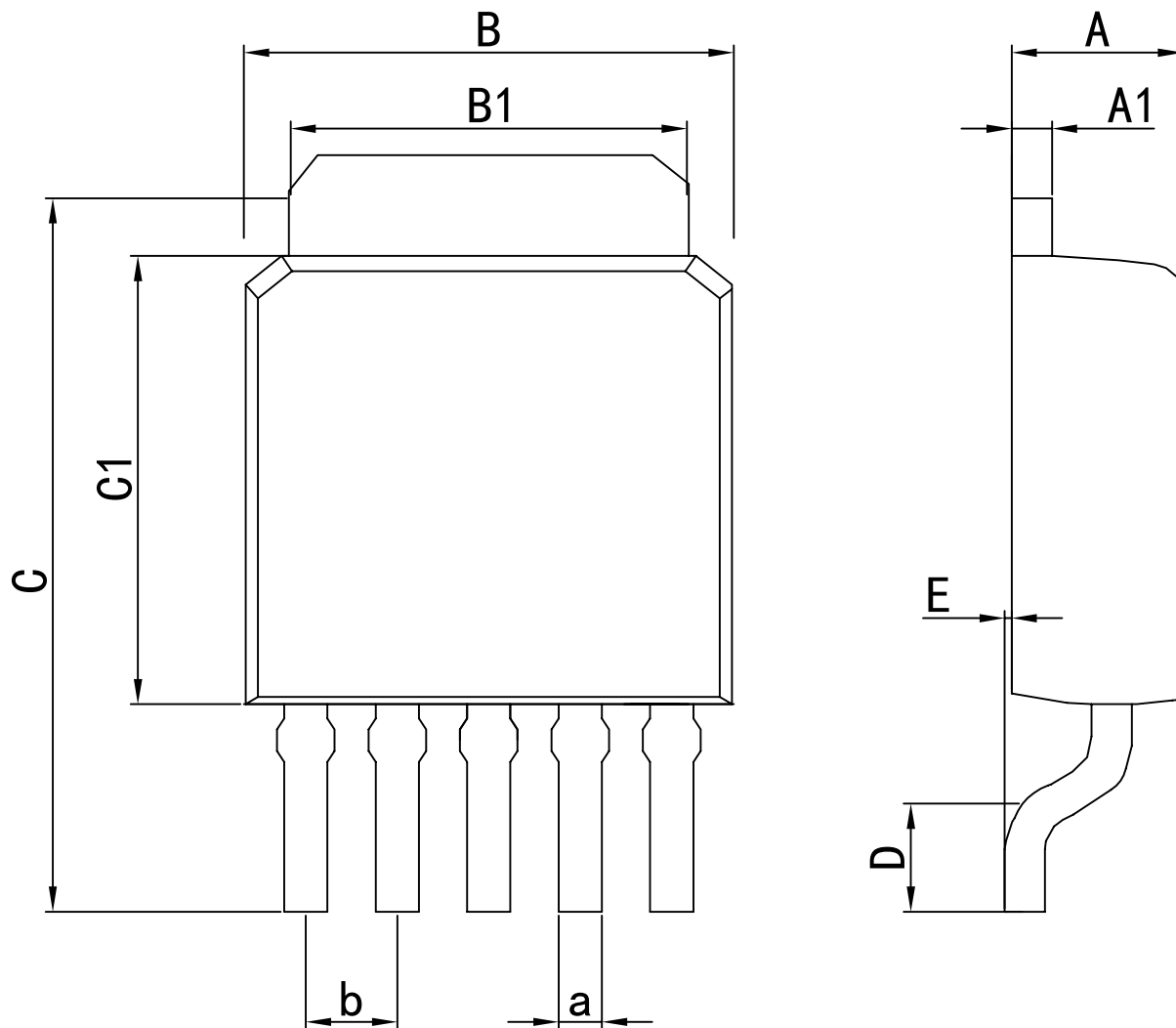




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司

Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



制图 赖谊成

审阅 罗云龙

核准 林钟涛

T0252-5

文件名称:
HG-T0252-5

文件编号:
HGWXT-230033

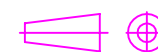
版本 V1.0

比例 1:1

单位 mm

日期 2023-6-29

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT:mm

DIM.	A	A1	B	B1	C	C1	D	E	a	b		
MIN	2.19	0.45	6.30	5.20	9.40	5.30	1.40	0.05	0.45	1.27		
MAX	2.38	0.55	6.70	5.50	10.2	5.70	1.60	0.25	0.60	BSC		